



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071017000

2008 年 3 月 14 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部  
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

SOT (5/6pin DBV) パッケージ一部製品 製造サイト 追加変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

|        |                                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通知タイプ  | <input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Final notice                                                                       |
| 変更概要   | Design/Specification                                                                               | <input type="checkbox"/> Design <input type="checkbox"/> Electrical <input type="checkbox"/> Mechanical                |
|        | Wafer Fab                                                                                          | <input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material                       |
|        | Wafer Bump                                                                                         | <input type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input type="checkbox"/> Material                       |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process <input checked="" type="checkbox"/> Material |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> Test                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Site <input type="checkbox"/> Process                                              |
|        | Others                                                                                             | <input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -                                          |
| 変更内容   | SOT (5/6pin DBV) パッケージ一部製品 製造サイト 追加<br>現行：Lingsen 社(台湾)<br>変更後：Lingsen 社(台湾)、UTAC 社(タイランド:旧 NSE 社) |                                                                                                                        |
| 対象製品   | 対象製品リスト参照                                                                                          |                                                                                                                        |
| 変更時期   | 6 月中旬の出荷より予定しています。                                                                                 |                                                                                                                        |
| 品質認定試験 | <input type="checkbox"/> 計画                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 終了                                                                                 |
| 製品表示   | <input checked="" type="checkbox"/> 変更無し                                                           | <input type="checkbox"/> 変更あり                                                                                          |
| 備考     | －                                                                                                  |                                                                                                                        |

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。  
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは[pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com)にお問い合わせ下さい。

以上

### 変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SOT(5/6pin DBV) パッケージ一部製品 製造サイトについて、現行Lingsen社(台湾)にて実施していますが、これに加えUTAC社(タイランド:IDNSE社)サイトを追加し認定しました。この変更に伴い各製造サイトにて量産に適用しております下記の部材の使用となります。尚、UTAC社(タイランド:IDNSE社)でのDBVパッケージ製品製造は、2004年2月に認定しております。また、出荷梱包部材につきましては、認定したサイトで現在使用しております部材とさせていただきます。

|       |              |                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------|
| 変更内容  | 現行           | 変更後                                 |
| 製造サイト | Lingsen社(台湾) | Lingsen社(台湾)<br>UTAC社(タイランド:IDNSE社) |

| 部材項目       | Lingsen社(台湾)        | UTAC社(タイランド:IDNSE社) |
|------------|---------------------|---------------------|
| マウントコンパウンド | SUMITOMO CRM-1033BF | ABLESTIK 84-1LMISR4 |
| モールドコンパウンド | SUMITOMO G600       | SUMITOMO G600       |

理由：製品供給安定確保の為

### 対象製品リスト

| 対象製品名         |                 |                 |                |               |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| SN65220DBVR   | SN65LVDS1DBVR   | SN65LVDS2DBVR   | SN65LVD2DBVR   | SN65LVD2YDBVR |
| SN65220DBVRG4 | SN65LVDS1DBVRG4 | SN65LVDS2DBVRG4 | SN65LVD2DBVRG4 |               |
| SN65220DBVT   | SN65LVDS1DBVT   | SN65LVDS2DBVT   | SN65LVD2DBVT   |               |
| SN65220DBVTG4 | SN65LVDS1DBVTG4 | SN65LVDS2DBVTG4 | SN65LVD2DBVTG4 |               |

### 信頼性試験

| 信頼性試験結果                                    |            |                      |           |                 |
|--------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 信頼性試験期間                                    | 開始         | -                    | 終了        | 2007 年 5 月 22 日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細                             |            |                      |           |                 |
| Qualification Device:                      | SN65220DBV | Assembly Site:       | UTAC /NSE |                 |
| Package:                                   | DBV        | Pin Count:           | 6         |                 |
| 信頼性試験結果                                    |            |                      |           |                 |
| Reliability Test                           |            | Condition / Duration |           | Results         |
| Manufacturability Qualification (Assembly) |            | Per TI requirements  |           | Approved        |

| 信頼性試験結果                                    |              |                      |           |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------|
| 信頼性試験期間                                    | 開始           | -                    | 終了        | 2007 年 8 月 7 日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細                             |              |                      |           |                |
| Qualification Device:                      | SN65LVDS1DBV | Assembly Site:       | UTAC /NSE |                |
| Package:                                   | DBV          | Pin Count:           | 5         |                |
| 信頼性試験結果                                    |              |                      |           |                |
| Reliability Test                           |              | Condition / Duration |           | Results        |
| Manufacturability Qualification (Assembly) |              | Per TI requirements  |           | Approved       |

| 信頼性試験結果                                          |                      |                         |               |                |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 信頼性試験期間                                          | 開始                   | —                       | 終了            | 2004 年 2 月 6 日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細                                   |                      |                         |               |                |
| Qualification Device:                            | TPS62202DBVT         | Die Size (mils):        | 53 x 41       |                |
| Wafer Fab Site:                                  | TID                  | Fab Process:            | 3370A12       |                |
| Metal1-3:                                        | TiW/AICu.5           | Passivation:            | 10KACN        |                |
| Assembly Site:                                   | NSE                  | Package/Pins:           | DBV / 5       |                |
| Mount Compound:                                  | ABL 84-1 LMISR4      | Mold Compound:          | SUM EME-G600  |                |
| Bond Wire:                                       | TS-1.0 Au            | LF Composition/ Finish: | Cu / NiPdAu   |                |
| Moisture Sensitivity Level:                      | L1-260C              | Flammability Rating:    | Class UL94-V0 |                |
| 信頼性試験結果                                          |                      |                         |               |                |
| Reliability Test                                 | Condition / Duration | Sample Size/ Fails      |               |                |
|                                                  |                      | Lot A                   | Lot B         |                |
| **Autoclave                                      | 121C, 240hrs         | 77/0                    | 77/0          |                |
| **Thermal Shock                                  | -65/150C, 1000cys    | 77/0                    | 77/0          |                |
| **Temp Cycle                                     | -65/150C, 1000cys    | 77/0                    | 77/0          |                |
| Manufacturability Qualification (MQ)             | Per TI requirements  | Approved                |               |                |
| Note: ** Preconditioning Sequence: Level 1, 260C |                      |                         |               |                |